

有研半导体硅材料股份公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和资料于2025年10月20日通过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长方永义先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案》

公司拟将“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”中一部分资金11,922万元用于新建“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”，原“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月；新建项目预计完成时间为2026年12月。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提请公司股东会审议批准。

（二）审议通过《关于公司 2024 年股票期权激励计划预留部分考核的议案》

为更好地发挥股权激励作用，确保公司长期发展目标的实现，公司结合相关

法律法规的规定和实际授予情况，进一步明确 2024 年股票期权激励计划预留部分分公司业绩考核要求和个人层面绩效考核要求。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划预留部分考核的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次会议审议通过。

（三）审议通过《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《有研半导体硅材料股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》规定，鉴于在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权股份登记期间，公司发生派发股票红利情况，股票期权的行权价格将根据本激励计划做相应的调整。经本次调整后，行权价格由 9.11 元/股调整为 9.05 元/股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份有限公司关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次会议审议通过。

（四）审议通过《关于确认公司2024年股票期权激励计划绩效考核结果的议案》

根据《有研半导体硅材料股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司2024年息税折旧摊销前利润（EBITDA）为4.11亿元，达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为80%。根据《有研半导体硅材料股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司对股票期权激励计划首次授予的92名激励对象进行了2024年度考核。其中，82名激励对象的年度绩效考核结果为“A”，10名激励对象的年度绩效考核结果为“B”。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2024 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次会议审议通过。

（六）审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划首次部分已授予但未获准行权的股票期权的议案》

根据《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，本激励计划首次授予第一个行权期公司层面 2024 年业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面可行权比例为 80%，部分激励对象因个人考核条件未达成 A 导致不能完全行权，公司及个人考核不达标部分的股票期权合计 75.42 万份，公司将注销该部分已授予但无法行权的股票期权。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》。

关联董事方永义、张果虎回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第二届董事会薪酬和考核委员会第五次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年第三季度报告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《有研半导体硅材料股份公

司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 50,000 万元（含本数）进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 11 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025 年 10 月 28 日